

# 加工

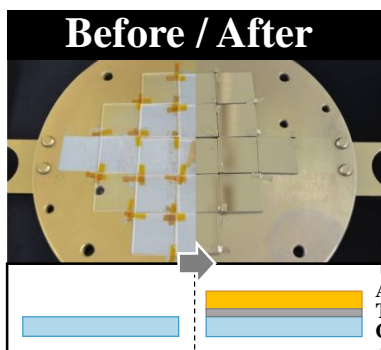
## (成膜装置群)

### 真空蒸着装置

ULVAC社製 VPC-1100

#### 仕様

到達真空度	$5 \times 10^{-5}$ Pa
成膜実績	Au, Ti, Cr, Al
試料台	2.5 インチ
膜厚	0.001 $\mu$ m ~
膜厚制御	0.01 nm/s



#### 薄膜成膜

抵抗加熱蒸着による金属材料の物理成膜が行えます。サンプルの試料台への設置から成膜まで手動で行いますので、基板成膜のほかにも立体構造への成膜が行えます。また、水晶振動子を取り付けているので、膜厚の確認、蒸着速度の観察を行いながら成膜することが可能です。

ナノメートル単位の膜厚、膜厚制御を必要とされる場合には本装置の利用を、それ以外の場合には、生産効率の高いスパッタ装置の利用をお勧めしております。

「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター  
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX: 087-887-1873

E-mail: [nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp](mailto:nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp)